

(43) 国際公開日  
2017年5月4日(04.05.2017)



(10) 国際公開番号

**WO 2017/073627 A1**



- |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(51) 国際特許分類:<br/> <i>C08F 2/46</i> (2006.01) <i>C09J 7/02</i> (2006.01)<br/> <i>C09J 4/00</i> (2006.01) <i>H01L 21/301</i> (2006.01)<br/> <i>C09J 7/00</i> (2006.01) <i>H01L 23/00</i> (2006.01)</p>                                           | <p>(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.</p> |
| <p>(21) 国際出願番号: PCT/JP2016/081752</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p>                                                                                                                              |
| <p>(22) 国際出願日: 2016 年 10 月 26 日(26.10.2016)</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>添付公開書類:<br/>         — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(25) 国際出願の言語: 日本語</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(26) 国際公開の言語: 日本語</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(30) 優先権データ:<br/>         特願 2015-212845 2015 年 10 月 29 日(29.10.2015) JP</p>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).</p>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(72) 発明者: 稲男 洋一(INAO Youichi); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小橋 力也(KOBASHI Rikiya); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 古野 健太(FUR-UNO Kenta); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

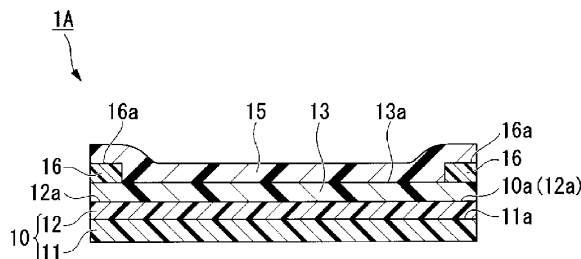
添付公開書類:

— 國際調查報告（條約第 21 條(3)）

**(54) Title:** FILM FOR PROTECTIVE FILM FORMATION AND COMPOSITE SHEET FOR PROTECTIVE FILM FORMATION

(54) 発明の名称：保護膜形成用フィルム及び保護膜形成用複合シート

[圖1]



**(57) Abstract:** A film for protective film formation, which contains an energy ray-curable compound (B) and has the characteristics described below, and which is used for the purpose of forming a protective film on the back surface of a semiconductor wafer or a semiconductor chip. If a cured product is obtained by curing this film for protective film formation by means of energy ray irradiation, the cured product has a Young's modulus of 500 MPa or more and an elongation at break of 8% or more.

(57) 要約: エネルギー線硬化性化合物 (B) を含み、以下の特性を有する半導体ウエハ又は半導体チップの裏面に保護膜を形成するための保護膜形成用フィルム: エネルギー線の照射によりこの保護膜形成用フィルムを硬化させて硬化物としたとき、この硬化物のヤング率が500MPa以上であり、かつ破断伸度が8%以上である。

**WO 2017/073627 A1**